

## 2012年3月期 通期決算概要

ルネサス エレクトロニクス株式会社

2012年5月9日

代表取締役社長 赤尾 泰

© 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

社長の赤尾でございます。

本日はご多忙のところお集まりいただき、ありがとうございます。

2012年3月期 通期の決算概要について説明いたします。

## エグゼクティブサマリー

### I. 2012年3月期 通期 決算概要

- 第4四半期は、売上高はほぼ想定どおりも、営業損益は生産減に伴う利益減などにより想定を下回った
- 通期では、震災、タイの洪水影響、欧州・中国を中心とした市況悪化などにより前年度比で売上高は大幅に減少、営業損益は研究開発費効率化、販売費及び一般管理費の削減などの費用削減施策を実行したものの、売上減による利益減をカバーするまでには至らず、赤字を計上

### II. 事業・生産構造対策の展開とコアコンピタンスの強化

- 事業の選択と集中及び生産構造の最適化を推進中
- 世界No.1シェアを堅持するマイコンをコアコンピタンスとして、自動車分野での不動のポジションを確立

こちらが本日の説明内容のサマリーでございます。

2012年3月期 第4四半期の売上高は、ほぼ想定どおりでしたが、営業損益は、生産減に伴う利益減などにより、想定を下回りました。

通期では、震災、タイの洪水影響、欧州・中国を中心とした市況悪化などにより、前年度比で売上高は大幅に減少しました。営業損益は研究開発費効率化、販売費及び一般管理費の削減などの費用削減策を実行したものの、売上減による利益減をカバーするまでには至らず、赤字を計上しました。

事業・生産構造対策の展開につきましては、事業の選択と集中及び生産構造の最適化を並行して推進しています。更に、世界No.1シェアを堅持するマイコンをコアコンピタンスとして、自動車分野での不動のポジションを確立しています。

## I. 2012年3月期 通期 決算概要

それでは、2012年3月期 通期の決算概要について、説明いたします。

## 2012年3月期 通期 決算概要

- 半導体売上高は、震災、タイの洪水影響、欧州・中国を中心とした市況悪化による需要減などにより、前期比で2,329億円の減少
- 営業損益は、研究開発費の効率化、販売費及び一般管理費の削減などの費用削減策を実行したものの、売上減による利益減をカバーするまでには至らず、赤字を計上

2012年3月期						
(単位:億円)	第4四半期	前四半期比		通期	前回予想比	前期比
売上高	2,097	△132		8,831	△19	△2,548
半導体売上高	1,858	△122		7,860	△20	△2,329
営業損益	△236	△196		△568	△88	△713
経常損益	△243	△207		△612	△72	△622
当期純損益	△182	△157		△626	△56	524
1US\$=	78円	1円 円安		79円	-	7円 円高
1ユーロ=	102円	3円 円高		109円	-	5円 円高

4 © 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

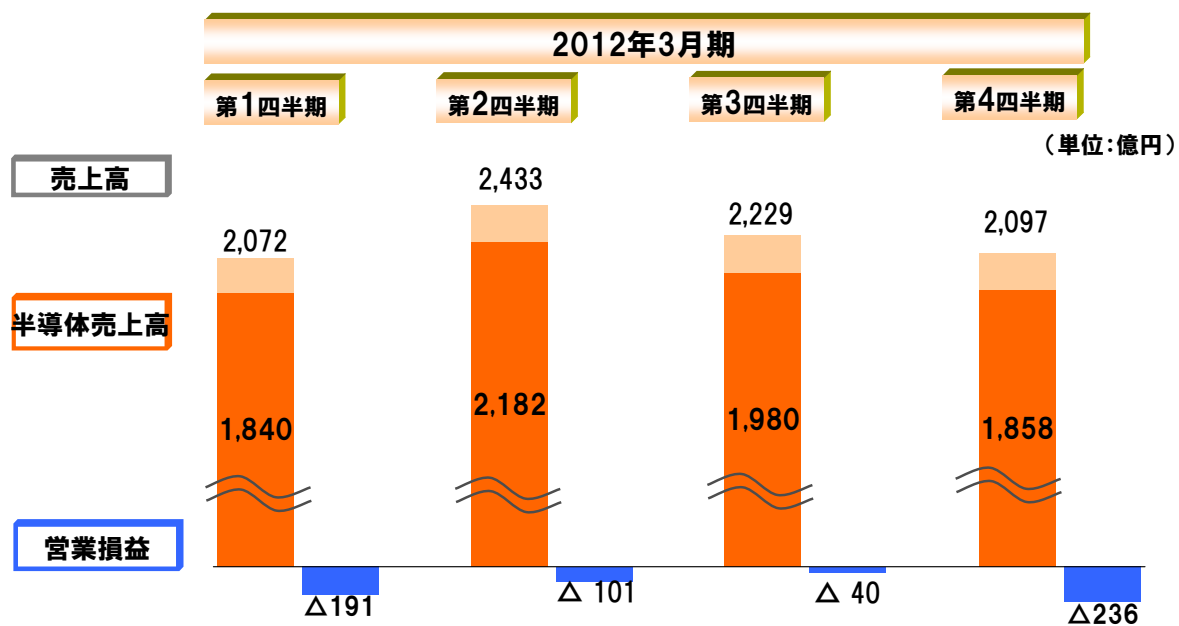
まず、通期実績のサマリです。

半導体売上高は、震災、タイの洪水影響、欧州や中国を中心とした市況悪化による需要減などにより、前期比で2,329億円減少の7,860億円となりました。

営業損益は、研究開発費の効率化や費用削減策を実行したものの、売上減による利益減をカバーするまでには至らず、赤字を計上しました。

## 2012年3月期 四半期業績推移

- 営業損益は、第3四半期にかけて改善傾向にあったものの、生産減などにより第4四半期は悪化



5 © 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

こちらが、四半期ごとの業績推移です。

営業損益は、第3四半期にかけて改善傾向にあったものの、生産減などにより第4四半期は悪化しました。

## 2012年3月期 半導体売上高の事業別状況①

- 第4四半期は、アナログ&パワー半導体が大幅減少の前四半期から+8.6%と回復傾向、マイコンも自動車向けを中心に堅調を維持したものの、SoCが全般的に下げ止まらず、半導体売上高は前四半期比6.1%の減少
- 日系自動車メーカーの増産に伴い、下期にかけて自動車向けマイコンが前年並みの水準に回復したものの、通期の半導体売上高は大幅減

2012年3月期				
(単位:億円)	第4四半期	前四半期比 (%)	通期	前期比 (%)
半導体売上高 計	1,858	△6.1%	7,860	△22.9%
マイコン	830	△6.3%	3,363	△12.4%
アナログ&パワー 半導体(A&P)	592	+8.6%	2,438	△22.9%
SoC	428	△19.9%	2,012	△35.5%
その他半導体	9		48	

6 © 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

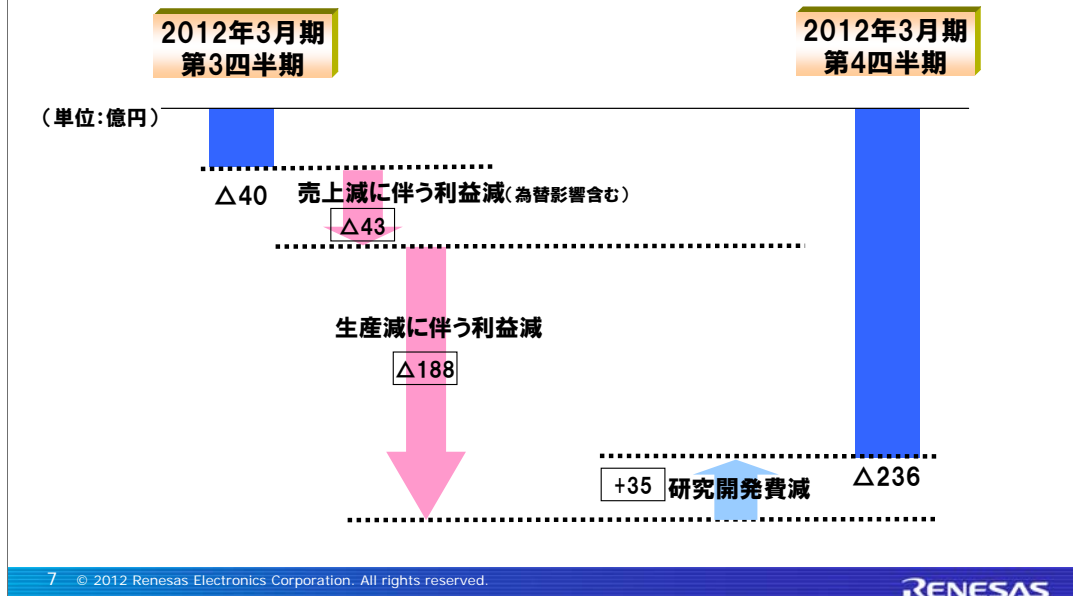
続いて、第4四半期及び通期の事業別の半導体売上高です。

第4四半期に入り、アナログ&パワー半導体は、大幅減少の前四半期から、+8.6%と回復傾向にあります。またマイコンも自動車向けを中心に堅調を維持しています。ただし、SoCが全般的に下げ止まらず、半導体売上高は前四半期比6.1%の減少となりました。

通期では、日系自動車メーカーの増産に伴い、下期にかけて自動車向けマイコンが前年並みの売上水準に回復したものの、震災、タイの洪水影響、欧州や中国を中心とした市況悪化による需要減などにより、半導体売上高は大幅減となりました。

## 2012年3月期 第4四半期営業損益（前四半期比）

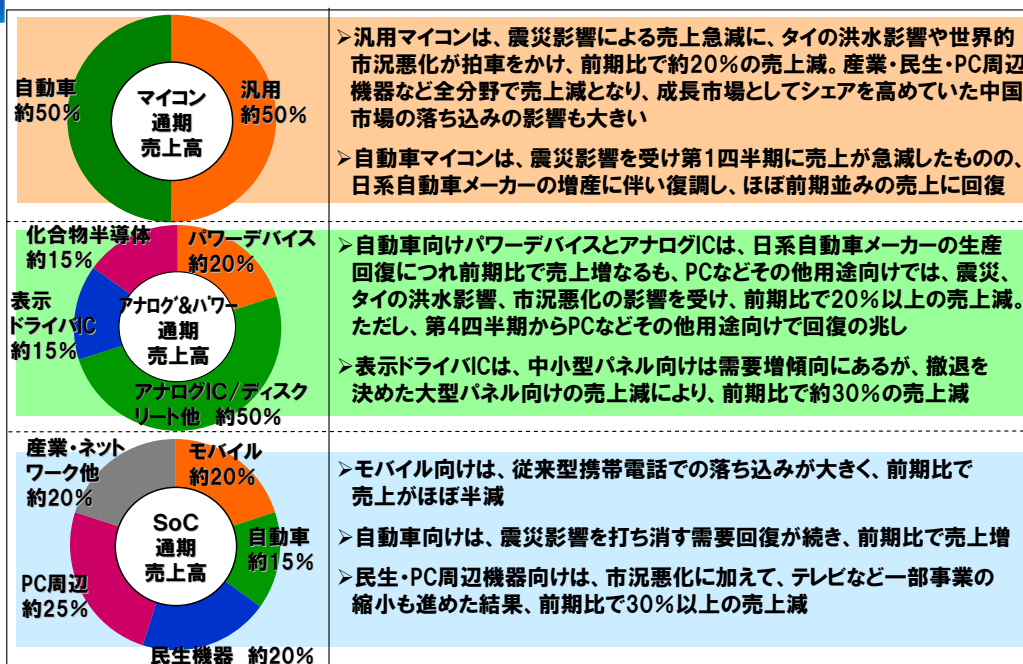
- 売上減に伴う利益減、生産減に伴う利益減により、196億円の悪化



7ページは、第4四半期の営業損益について、前四半期からの増減で示したものです。

第4四半期は、研究開発費の効率化を推進したものの、売上減に伴う利益減や生産減に伴う利益減により、営業損益は196億円悪化し、236億円の赤字となりました。

## 2012年3月期 半導体売上高の事業別状況②



8 © 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

8ページは、2012年3月期 通期の各事業別の売上について、分野別での状況を示したものです。

マイコンにおいては、汎用マイコンは、震災影響による売上急減に、タイ洪水影響や世界的市況悪化が拍車をかけ、前期比で約20%の売上減となりました。一方、自動車マイコンは、震災影響を受けて第1四半期に売上が急減したものの、日系自動車メーカーの増産に伴い復調し、ほぼ前期並みの売上に回復しました。

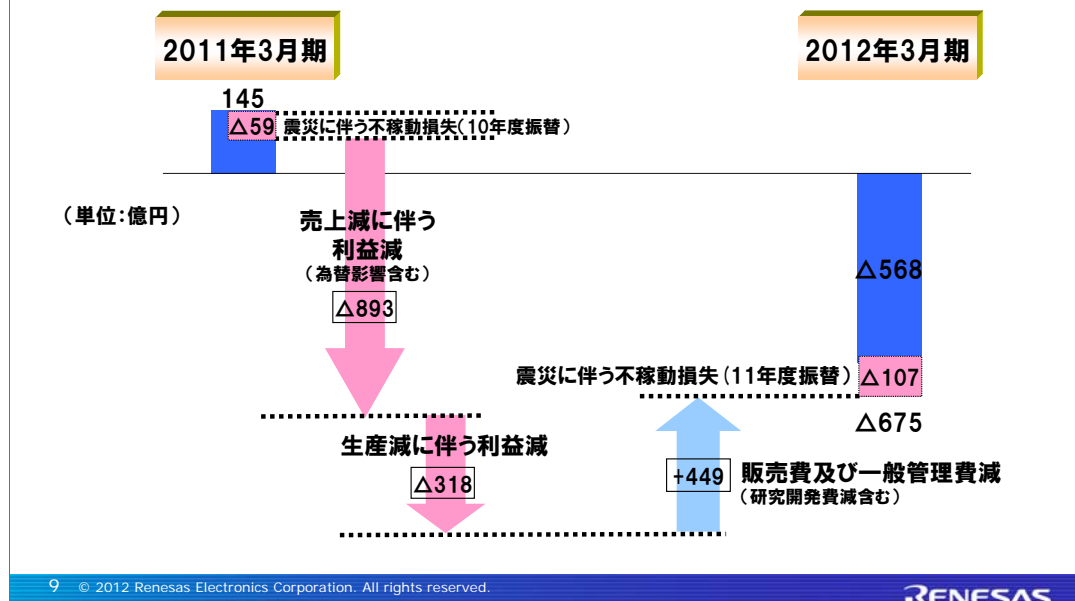
アナログ&パワー半導体においては、自動車向けパワーデバイスとアナログICは、日系自動車メーカーの生産回復につれ前期比で売上増になりました。PCなどその他用途向けでは、震災等の影響を受け、前期比で約20%以上の売上減となりました。ただし、第4四半期からPCなどその他用途向けで回復の兆しが見え始めています。

SoCにおいては、モバイル向けは、従来型携帯電話での落ち込みが大きく、前期比で売上はほぼ半減しました。自動車向けは、震災影響を打ち消す需要回復が続き、前期比で売上増となりました。民生・PC周辺機器向けは、市況悪化に加えて、テレビなど一部事業の縮小も進めた結果、前期比で30%以上の売上減となりました。



## 2012年3月期 通期営業損益（前期比）

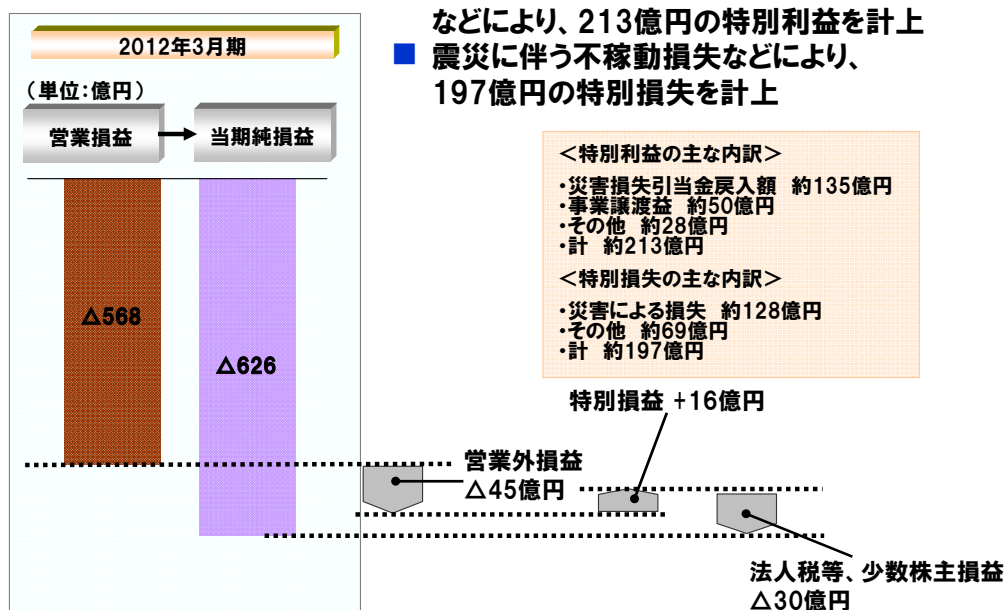
- 売上減、生産減に伴う利益減を、研究開発費の効率化を含む、販売費及び一般管理費の削減などによりカバーしたものの、営業損益は赤字を計上



9ページは、2012年3月期 通期の営業損益について、前期からの増減で示したものです。

2011年3月期、2012年3月期は共に、震災に伴う不稼働損失をそれぞれ特別損失として計上しましたので、これを営業損益に加えて比較しています。震災やタイの洪水影響などによる売上減や生産減に伴う利益減が、約1,200億円あったものの、研究開発費の効率化を含む販売費及び一般管理費の削減などにより、約450億円の改善を進め、2012年3月期は568億円の営業損失となりました。

## 2012年3月期 当期純損益の状況



10 © 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

10ページは、通期の当期純損益の状況について、営業損益からの増減を示したものです。

特別損益の内訳として、災害損失引当金の戻入やパワーアンプ事業の譲渡などにより、213億円の特別利益を計上しました。また、震災に伴う不稼働損失などにより、197億円の特別損失を計上しました。

## バランスシートの状況

(単位:億円)	11/4期首	11/12末	12/3末
<b>総資産</b>	11,450	9,017	8,582
<b>うち 現金及び現金同等物</b>	3,373	1,578	1,319
<b>うち たな卸資産</b>	1,234	1,577	1,518
<b>負債合計</b>	8,540	6,654	6,317
<b>うち 有利子負債</b>	3,782	2,633	2,583
<b>株主資本</b>	3,060	2,616	2,434
<b>純資産合計</b>	2,911	2,363	2,265
<b>D/Eレシオ(グロス)</b>	1.33倍	1.15倍	1.19倍
<b>D/Eレシオ(ネット)</b>	0.14倍	0.46倍	0.58倍
<b>自己資本比率</b>	24.8%	25.3%	25.4%

(注)①現金及び現金同等物:「現金及び預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3ヶ月を超える定期預金」を控除しております。  
 ②有利子負債:「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「リース債務」、「長期借入金」  
 ③自己資本:「株主資本」、「その他の包括利益累計額」 ④D/Eレシオ(グロス):有利子負債/自己資本

11ページは、バランスシートの状況です。

現金及び現金同等物は、震災関連の支払いなどが発生し、前四半期比約260億円減の1,319億円となりました。

## キャッシュ・フローの状況

- 税金等調整前当期純損失の計上、有形固定資産の取得による支出などにより、通期のフリー・キャッシュ・フローは648億円の赤字

2012年3月期					
(単位：億円)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	通期
営業活動による キャッシュ・フロー	△292	80	180	△66	△97
投資活動による キャッシュ・フロー	△148	△178	△152	△73	△551
フリー・ キャッシュ・フロー	△440	△97	29	△140	△648

12ページは、キャッシュ・フローの状況です。

通期のフリー・キャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純損失の計上や有形固定資産の取得による支出などにより、648億円の赤字となりました。

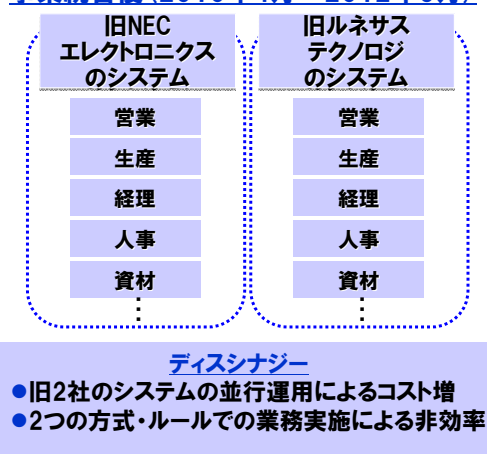
## II. 事業・生産構造対策の展開とコアコンピタンスの強化

次に、事業・生産構造対策の展開とコアコンピタンスの強化について説明いたします。

## 事業統合3年目を迎えて –新統合システムのスタート

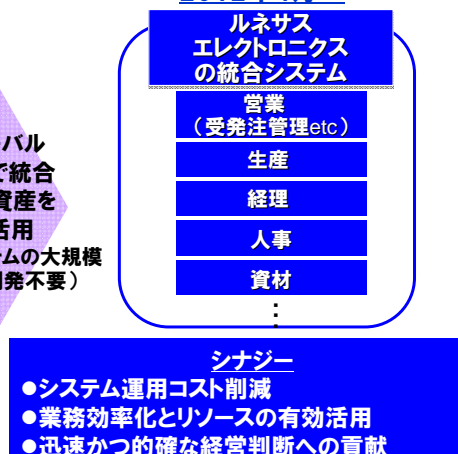
- 事業統合の最終段階として、営業・生産・経理・人事など会社運営全般にわたる制度を一本化
- ITシステムを統合し、4月から新システムを稼働
- 早期のシステム統合により、費用対効果の高い事業運営を進める

### 事業統合後(2010年4月～2012年3月)



- グローバル規模で統合
- 既存資産を有効活用  
(システムの大規模新規開発不要)

### 2012年4月～



2010年4月にルネサス エレクトロニクスとして発足してから、今年度で3年目を迎えました。事業統合の最終段階として、営業・生産・経理・人事など、会社運営全般にわたる制度を一本化した上で、ITシステムを統合し、この4月から新システムを稼働させました。早期で完了したシステム統合により、費用対効果の高い事業運営を進めてまいります。

## 事業・生産構造対策の展開

### ■ 事業の選択と集中及び生産構造の最適化を推進中

	2011年度中に実施・発表した事業・生産構造対策
事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パワーアンプ事業を村田製作所に譲渡（12年3月完了）</li> <li>・大型表示ドライバIC事業撤退（12年3月新規開発完了）</li> <li>・コンシューマ向けなど短ライフサイクルのSoC製品の集約</li> </ul>
生産 (前工程)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ローズビル8インチライン*1をTelefunkenに譲渡（11年5月完了）</li> <li>・甲府6インチライン*2を縮小（11年9月完了）</li> <li>・高崎5インチライン*3を縮小（11年12月完了）</li> <li>・滋賀5インチライン*4を集約（12年3月完了）</li> <li>・津軽6インチライン*5を富士電機に譲渡（12年7月予定）</li> </ul>
生産 (後工程)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・閉鎖した福岡工場*6の土地を売却（11年9月完了）</li> <li>・パワーアンプ生産の長野工場*7を村田製作所に譲渡（12年3月完了）</li> <li>・青梅工場*8を閉鎖（12年3月完了）</li> </ul>

\*1) ルネサス エレクトロニクス アメリカ ローズビル工場(アメリカ、カリフォルニア)  
 \*2) ルネサス エレクトロニクス 甲府工場 (山梨県甲斐市)  
 \*3) ルネサス エレクトロニクス 高崎工場 (群馬県高崎市)  
 \*4) ルネサス関西セミコンダクタ 滋賀工場(滋賀県大津市)

\*5) ルネサス北日本セミコンダクタ 津軽工場(青森県五所川原市)  
 \*6) ルネサス セミコンダクタ九州・山口 福岡工場(福岡県柳川市)  
 \*7) ルネサス東日本セミコンダクタ 長野デバイス本部 (長野県小諸市)  
 \*8) ルネサス東日本セミコンダクタ 東京デバイス本部 (東京都青梅市)

15 © 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

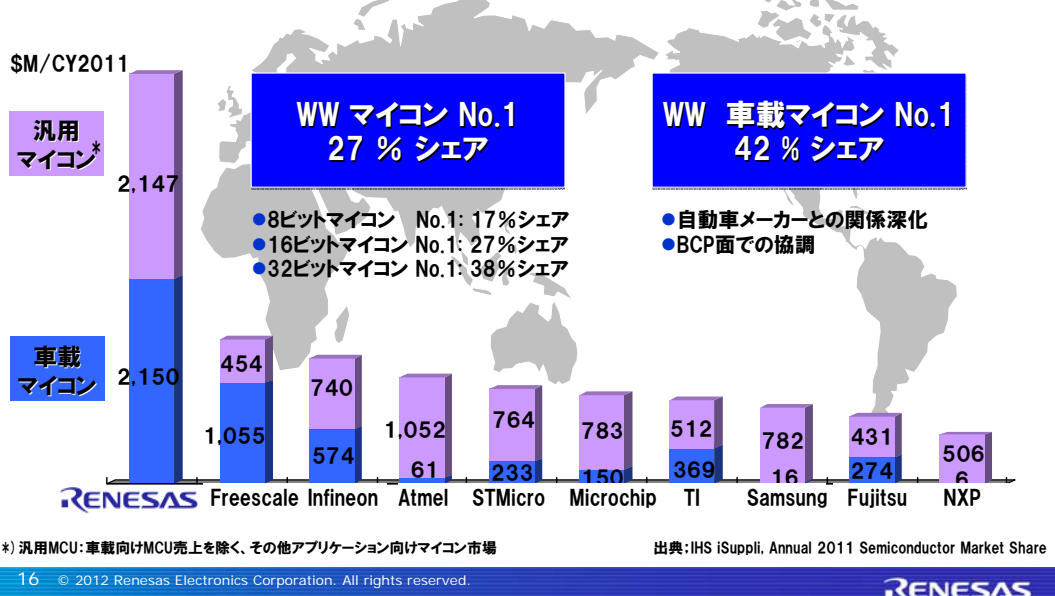
RENESAS

続いて、統合来計画に従って進めている事業・生産構造対策の展開について、説明いたします。

こちらの表が、2011年度中に実施・発表した事業・生産構造対策の一覧です。パワーアンプ事業の村田製作所への譲渡や大型表示ドライバIC事業の撤退など、事業の選択と集中を進めています。また、ローズビル8インチラインの譲渡など、生産構造の最適化も推進しております。

## コアコンピタンスの強化 – マイコン：世界No.1を堅持

- 2011年のマイコンシェアは27%と世界No.1を堅持
- 震災からの復旧を通して、自動車メーカーとの関係が強化されると共に、車載マイコンでのシェアNo.1も堅持し、圧倒的優位なポジションは変化なし



一方で、当社のコアコンピタンスの強化も継続して進めております。




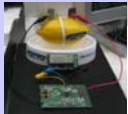
特に世界No.1のマーケットシェアを持つマイコンについては、そのポジションの堅持に努めています。昨年は当社生産拠点の被災による製品供給不安でお客様にはご心配をおかけしましたが、調査会社iSuppliの調査によると、当社マイコンの2011年の世界シェアは27%でNo.1でした。

更に、震災で実際に被災した教訓を活かして策定したBCP強化策を通して、これまで以上に既存の自動車メーカーとの関係を強化していきます。また、これまで相対的にシェアの低かった海外自動車メーカーとのより強固な関係が、震災以降に構築できつつあります。日本および海外市場での車載マイコンにおいて更なるシェア獲得を目指します。



## コアコンピタンスの強化 -マイコンNo.1の源泉：成長市場に最適な3コア

- マイコンコアを3コアに集約し、リソースを集中
- 成長市場の幅広いアプリケーションをカバーし、各々において最適な強みを発揮

	ローエンド (8/16 bit)	ミッドレンジ (32bit CISC*1)	ハイエンド (32bit RISC*2)
			
<b>狙う 成長市場</b>	<b>新興国市場</b> -小規模システム向け	<b>スマート社会市場</b> -インバータ機器など	<b>自動車</b> -エンジン制御など
<b>強み</b>	<b>フルラインアップ</b> -各アプリケーションに最適なメモリサイズ・パッケージ(ピン数)を提供		
	<b>低消費電力</b> -RL78, RX, RH850 それぞれで業界最小の消費電力を実現		
	<b>高信頼性</b>		
	-レモン1個で、超低電力マイコンの動作を実証 -不良率0.4ppm(1/250万個の不良品)を実現 -高信頼性や手厚いサポート実績に対し、自動車/電装メーカーなどからの表彰・感謝状		

\*1) CISC: Complex Instruction Set Computer. \*2) RISC: Reduced Instruction Set Computer

17 © 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. **RENESAS**

こうした世界No.1のマイコンの強さの源泉は、成長市場に最適な当社の3つのマイコンコアとマイコンに組み込むフラッシュメモリにあると考えています。

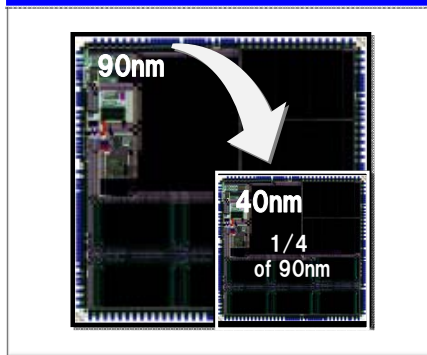
マイコンのコアについては、2年前の統合当初は、5つありましたが、2年を経て、ローエンドはRL78、ミッドレンジはRX、ハイエンドはRH850の3つに集約し、開発・営業リソースを集中させています。これら3コアは、フルラインアップ、低消費電力、高信頼性という共通した強みを持っています。RL78は新興国市場、RXはスマート社会市場、RH850は自動車、とそれぞれ今後成長する市場を中心とした幅広いアプリケーションに向けて提供し、最適な強みを発揮してまいります。

## コアコンピタンスの強化

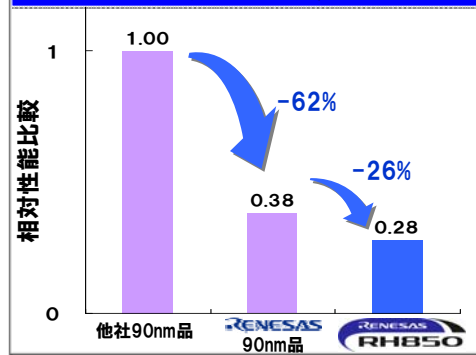
### —RH850: 自動車分野で他社の追随を許さない世界初40nmマイコン

- 世界に先駆けて、最先端の40nmプロセスのフラッシュマイコンを開発
- 独自開発のメモリセル技術「MONOS\*」構造のフラッシュメモリを内蔵し大容量プログラム格納のみならず、高信頼性・高速動作・低消費電力を実現

#### 世界最小メモリセル



#### 世界最小の消費電力



**高信頼・高速・低消費電力が要求される自動車に展開、採用拡大中**  
(12年度上期サンプル出荷、マルチファブにて量産開始予定)

\*) MONOS: Metal-Oxide-Nitride-Oxide-Silicon

先のページでお話した中でも、ハイエンドのRH850については、世界初の40nmプロセスを採用しています。これにより、世界No.1シェアの自動車分野において、他社の追随を許さず不動のポジションを確立できると考えています。

また、当社マイコンの競争力のもう1つの柱は、独自開発の「MONOS」構造を有するフラッシュメモリです。40nm採用により、現行の90nmと比べて、四分の一の世界最小のメモリセルを実現し、大容量プログラム格納のみならず、高信頼性・高速動作・低消費電力を実現しています。

当社はRH850を今後ますます高信頼・高速・低消費が要求される自動車に対して展開していきます。既に採用も拡大しており、12年度上期のサンプル出荷を見込んでおり、量産時にはマルチファブ展開を行う予定です。

## コアコンピタンスの強化

### －アナログ・パワー半導体：自動車など成長市場への攻勢

- 世界No.1マイコンとの組み合わせにより、アナログ・パワー半導体の自動車分野での商機が拡大、売上最大化を狙う
- 低耐圧～高耐圧まで、3年間でパワー半導体1,000製品開発を目指し、開発リソースを集中してラインアップ拡充中(現在650製品開発済み)
- スマホ・タブレットPCの成長市場における、需要の確実な取り込みと掘り起こし



自動車分野でのマイコンの強いポジションに続くべく、アナログ&パワー半導体も自動車をはじめとする成長市場に攻勢をかけています。

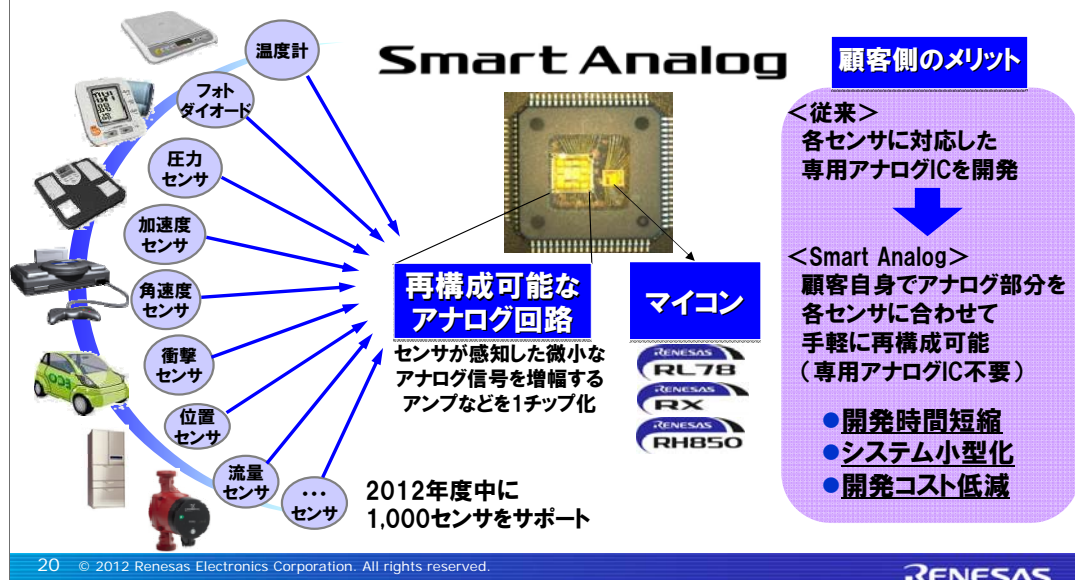
当社の自動車向け半導体売上としては、現在マイコンが約7割を占め、アナログ&パワー半導体が約2割を占めています。マイコンと比べて売上の少ないアナログ&パワー半導体を、世界No.1シェアのマイコンと組み合わせることで、自動車分野での商機が拡大すると見ており、売上の最大化を狙います。

特にパワー半導体については、自動車をはじめとした幅広いアプリケーション向けに、低耐圧から高耐圧まで、3年間で1,000製品の開発を目指し、開発リソースを集中してラインアップを拡充しています。

自動車だけでなく、スマートフォンやタブレットPCの成長市場に向けても、中小型表示ドライバや電池MOSFETなど強みを持つ当社製品を提供してまいります。例えば、中小型表示ドライバは現在世界シェアNo.2ですが、拡大するスマートフォン市場の需要を確実に取り込むことで、世界シェアNo.1を実現します。

## コアコンピタンスの強化 – Smart Analog: マイコンとアナログの融合

- マイコンと再構成可能なアナログ回路を組み合わせたSmart Analogを開発
- スマート社会を構成する各種機器に搭載される複数センサに1つで対応可能し、顧客側でのシステムの開発時間短縮と小型化に貢献

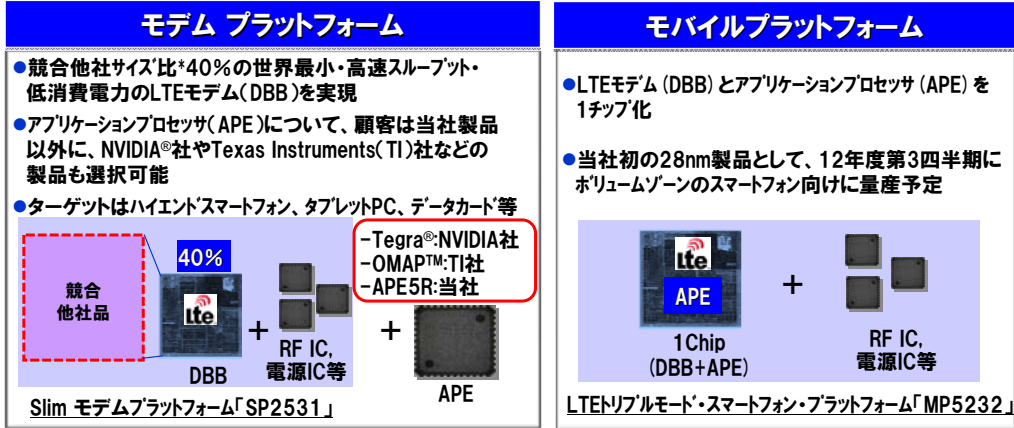


当社最大のコアコンピタンスであるマイコンにアナログを融合したSmart Analogという新製品を昨年度から市場投入しました。

Smart Analogとは、マイコンと再構成可能なアナログ回路を組み合わせた製品です。同製品は、スマート社会を構成する各種機器に搭載される複数の異なるセンサに1つで対応可能です。また、お客様サイドでのシステム開発時間を短縮し、更にシステムの小型化に貢献できると考えています。2012年度中には1,000センサをサポートする計画で、製品展開を進めています。

## LTEモデム：更なる成長に向けた挑戦

- 世界最小・最高速スループットのLTEモデムと最適なアプリケーションプロセッサのチップセット、または1チップ化製品によりスマートフォン市場を攻略



### スマートフォンに加え、通信機能を搭載する多種モバイル端末に展開

- 現在14社 (内9社が海外) にデザインイン済み

\* 当社と同じ45nm CMOSプロセスで製造された他社のLTEマルチモードモデムと比較

NVIDIA、Tegraは米国及びその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。OMAPはTexas Instrumentsの商標です。

21 © 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

更なる成長に向けた挑戦として、LTEモデム事業の強化を継続しています。

ノキアから買収したモデム技術を元に、競合他社40%サイズ比の世界最小・最高速スループット・低消費電力のLTEモデムを実現しています。LTEモデムと最適なアプリケーションプロセッサのチップセットをモデムプラットフォームとして、スマートフォンなどに向けて提供しています。一方、LTEモデムとアプリケーションプロセッサを1チップ化し、モバイルプラットフォームとして、ボリュームゾーンのスマートフォン向けに提供しています。1チップ化製品は、当社初の28nm製品として、12年度第3四半期から量産する予定です。

モデムプラットフォームとモバイルプラットフォームを、スマートフォンだけでなく、通信機能を搭載する多種モバイル端末に展開してまいります。現時点ではデザインインが14社に増加しており、更なるデザインイン拡大を目指します。

## 2013年3月期 業績見通しについて

- 東日本大震災やタイの洪水影響、欧州・中国を中心とした経済環境の悪化、長引く円高の影響などにより、2012年3月期の当社の連結売上高は、前期比で約22%の大幅減収となり、626億円の当期純損失を計上しました。
- 足元の半導体市況に関しては、一部で改善の兆しが見られるものの、全般的には未だ厳しく、先行き不透明な状況が続いております。このような中、当社としましては、今暫く、今後の半導体市況について見極める必要があると考えています。また、当社は昨年8月の事業方針発表以降、安定した利益を上げるべく事業ポートフォリオの見直しを進めており、その影響も十分勘案する必要があると考えています。
- よって、現時点において、2013年3月期の連結業績予想値は開示しておりません。今後、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに公表いたします。

最後に、2013年3月期の業績見通しについてですが、今回の発表は見送らせていただきました。その背景をご説明いたします。

東日本大震災やタイ洪水の影響、欧州・中国を中心とした経済環境の悪化、長引く円高の影響などにより、2012年3月期の当社の連結売上高は、前期比で約22%の大幅減収となり、626億円の当期純損失を計上しました。

足元の半導体市況に関しては、一部で改善の兆しが見られるものの、全般的には未だ厳しく、先行き不透明な状況が続いております。このような中、当社としましては、今暫く、今後の半導体市況について見極める必要があると考えています。また、当社は昨年8月の事業方針発表以降、安定した利益を上げるべく事業ポートフォリオの見直しを進めており、その影響も十分勘案する必要があると考えています。

よって、現時点において、2013年3月期の連結業績予想値は開示しておりません。今後、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに公表いたします。

(将来予測に関する注意)

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略及び業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与える重要な要因としては、(1)ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。



ルネサス エレクトロニクス株式会社

© 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

2012年3月期 通期の決算概要のご説明は以上でございます。本日は有難うございました。